

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010515677      \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1996-012628/199602

XRAM Acc No: C96-004110

XRPX Acc No: N96-010775

**Flat cold cathode electron emitter for e.g. flat image displays - has flat substrate, low work function electron emission layer and apertured conductive contact, insulation and gate layers.**

Patent Assignee: MOTOROLA INC (MOTI )

Inventor: MOYER C D

Number of Countries: 005    Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 685869	A1	19951206	EP 95108078	A	19950526	199602 B
US 5473218	A	19951205	US 94251415	A	19940531	199603
TW 267234	A	19960101	TW 95103854	A	19950419	199612
JP 8055564	A	19960227	JP 95151157	A	19950526	199618
EP 685869	B1	19980923	EP 95108078	A	19950526	199842

Priority Applications (No Type Date): US 94251415 A 19940531

Cited Patents: EP 520780

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 685869	A1	E	13	H01J-001/30	
-----------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): FR NL

US 5473218	A		9	H01J-019/00	
------------	---	--	---	-------------	--

JP 8055564	A		9	H01J-001/30	
------------	---	--	---	-------------	--

EP 685869	B1	E		H01J-001/30	
-----------	----	---	--	-------------	--

Designated States (Regional): FR NL

TW 267234	A			H01J-019/24	
-----------	---	--	--	-------------	--

Abstract (Basic): EP 685869 A

Flat cold-cathode electron emitter has: substrate 933); low work function electron emission material layer (34); contact conductive layer (35) having aperture (37); insulating layer (38) having aligned aperture (39); and conductive gate layer (40). The electron emission material pref. has a work function of less than 1.0 eV, and is pref. diamond, (non-crystalline) diamond-like carbon or AlN.

USE - Esp. is flat field emission displays.

ADVANTAGE - Extraction electrode current is reduced, dielectric breakdown is reduced, electron injection into surrounding dielectrics is reduced and the emitter operates with improved efficiency.

Dwg.3/10

Abstract (Equivalent): US 5473218 A

A flat, cold-cathode electron emitter comprising;

a substrate having a relatively flat surface;

a low work function electron emission material layer for emitting electrons supported on the surface of the substrate;

a contact conductive layer disposed on the low work function electron emission material layer and having an aperture defined through it;

an insulating layer disposed on the contact conductive layer and having an aperture defined through it in peripheral alignment with the aperture in the contact conductive layer; and

a conductive gate layer disposed on the insulating layer.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-55564

(43)公開日 平成8年(1996)2月27日

(51)IntCl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 J 1/30	B			
	C			
31/15	C			
H 0 5 B 33/00				

審査請求 未請求 請求項の数3 F D (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平7-151157

(22)出願日 平成7年(1995)5月26日

(31)優先権主張番号 2 5 1 4 1 5

(32)優先日 1994年5月31日

(33)優先権主張国 米国 (U S)

(71)出願人 390009597

モトローラ・インコーポレイテッド  
MOTOROLA INCORPORAT  
RED

アメリカ合衆国イリノイ州シャンバーグ、  
イースト・アルゴンクイン・ロード1303

(72)発明者 カーティス・ディー・モイヤー

アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス、  
イースト・ティストル・ランディング・ド  
ライブ4006

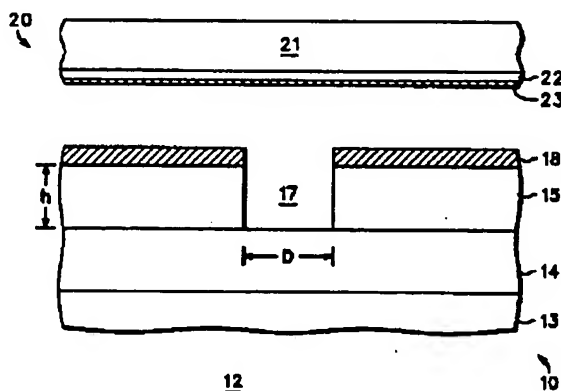
(74)代理人 弁理士 本城 雅則 (外1名)

(54)【発明の名称】 電子放出制御のためのパターニングされた金属を用いたダイヤモンド冷陰極

(57)【要約】

【目的】 電子放出制御のためにパターニングされた金属を用いて、抽出電極電流を大幅に低減すると共に、周囲の誘電体への電子注入を減少或いは解消する平面冷陰極電子エミッタを提供する。

【構成】 平面冷陰極電子エミッタ (30) は、比較的平面な表面を有する基板を含み、この基板の表面に電子を放出するための低仕事関数の電子放出物質層 (34) が形成されている。電子放出物質層 (34) 上に接触導電層 (35) を配置し、それを貫通する開口 (37) を規定する。接触導電層 (35) 上に絶縁層 (38) を配置し、接触導電層 (35) 内の開口の延長上にありかつそれと周囲が整合された開口 (39) を絶縁層 (38) に規定し、絶縁層 (38) 上に導電ゲート層 (40) を配置する。接触導電層 (35) は電界電位を形成するので、放出は実質的に開口 (37) の中央で起こる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】平面冷陰極電子エミッタ(30)であって：比較的平面な表面を有する基板(33)；前記基板表面に支持され、電子を放出する低仕事関数電子放出物質層(34)；前記低仕事関数電子放出物質層(34)上に配置され、開口(37)が規定された接触導電層(35)；前記接触導電層(35)上に配置され、前記接触導電層(35)内の前記開口(37)と実質的に周囲が整合された開口(39)が規定された絶縁層(38)；および前記絶縁層(38)上に配置された導電ゲート層(40)；から成ることを特徴とする平面冷陰極電子エミッタ(30)。

【請求項2】平面電子エミッタ(30)を有する電界放出素子(32)であって：光学的に透明な面板構造体(42)と離間された関係で位置付けられた電子エミッタ(30)であって、

電子を放出する電子放出物質層(34)、前記電子放出物質層(34)上に配置され、開口(37)が規定された導電接触層(35)、前記導電接触層(35)の上側に位置する関係で配置され、実質的に前記接触導電層の開口と同一の広がり有しかつ前記開口と周囲が整合された開口(39)が規定された絶縁層(38)、および前記絶縁層上に配置される導電ゲート層(40)であって、実質的に同一の広がりを規定する開口(41)を有し、前記開口(41)は前記導電層および前記絶縁層における前記開口と周囲が整合された導電ゲート層(40)を含む前記電子エミッタ(30)；ならびに主面を有し、その上に透明面板(43)と陰極ルミネセンス物質(44)とが形成された、光学的に透明な面板構造体(42)であって、前記光学的に透明な面板(42)の主面は前記導電接触層、前記絶縁層、および前記電子放出物質層に対向する前記導電ゲート層を貫通して規定された開口(41、39、37)の上側に位置する前記面板構造体；から成ることを特徴とする電界放出素子。

【請求項3】平面電子エミッタ(60)を有する電界放出素子(100)であって：主面を有し、透明面板(101)、陰極ルミネセンス物質(111)および導電陽極(110)を含む光学的に透明な面板構造体；前記面板構造体の前記主面上に配置され、開口(103)が規定され、該開口(103)が間空領域を規定する、間空絶縁層(102)；電子エミッタ(140)であって、電子を放出する電子放出物質層(106)、前記電子放出物質層(106)上に配置された導電接触層(107)、全体的に前記導電接触層(107)の上側に位置付けられる関係で配置された絶縁層(108)、前記絶縁層(108)上に配置された導電ゲート層(109)を含み、

前記電子エミッタは、前記導電接触層(107)、前記

絶縁層(108)、および前記導電ゲート層(109)を貫通して規定された少なくとも1つの開口(142)を有する電子エミッタ(140)；から成り、

前記電子エミッタ(140)は、前記導電ゲート層(109)が前記導電陽極(110)と前記電子放出層(106)との間に介在するように、前記間空絶縁層(102)上に配置され、かつ前記電子エミッタ(140)を貫通して規定された開口(142)が前記間空絶縁層(102)を貫通して規定された開口(103)と実質的に周囲が整合されるように配置され、

前記電子エミッタ(140)を貫通して規定された開口(142)および前記間空絶縁層(102)を貫通して規定された開口(103)の吸引時に、前記電子放出物質層(106)によって放出された電子が、前記間空領域の範囲を横切り、前記陰極ルミネセンス物質(111)からの光子の放出を励起するように配置された前記電子エミッタ(140)；から成ることを特徴とする電界放出素子。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は一般的に冷陰極電子放出素子(cold cathode emission devices)に関し、特にダイヤモンド物質を用いた電子エミッタ(electron emitter)および低仕事関数(work function)物質を用いた同様のエミッタに関するものである。

【0002】

【従来の技術】冷陰極電子エミッタは、主に電界放出素子(field emission device)を含み、これは、先端表面における電界を高めて十分に電子を引き出す(draw off)即ち放出するために、元来非常に鋭い先端を必要とするものであった。一般的に、抽出電極(extraction electrode)は先端を含む面内に形成され、この先端を完全に包囲して、チップと抽出電極との間に抽出電位を与えるように配置される。これらの素子に伴う主要な問題は、非常に鋭い先端の製造が難しいことである。更に、一旦チップを製造すると、電界放出素子を動作させるに連れて、チップが劣化する即ち粒子(particle)を失う傾向がある。

【0003】これらの問題を解決するために、エミッタに低仕事関数物質を利用しようとする動きがある。ダイヤモンド・エミッタを利用する場合のように、場合によっては、合理的な電位の印加で必要とする電子放出量を確保しつつ、エミッタを事実上平面構造とすることもできる。かかる構造の例は、"Electron Device Employing a Low/Negative Electron Affinity Electron Source"と題され、本願と同一譲受人に譲渡された米国特許第5,283,501号に開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】これら低仕事関数素子においても、抽出格子電流(extraction grid current)

3

が多すぎるという問題が存在する。鋭い先端を用いる場合、放出は自動的にエミッタの中央で行われ、電子流が陽極/スクリーンに衝突する前に、それを合焦させればよい。平面エミッタを用いる場合、電界内のどこでもその表面から電子を放出し得るので、結果的に放出電子の大部分が直接抽出電極に流れる。抽出電極に電流が流れると、素子の効率および動作特性を大きく低下させることになる。

【0005】したがって、上述の従来技術の欠陥の少なくともいくつかを克服する平面冷陰極放出素子が必要とされている。

【0006】本発明の目的の1つは、電子放出制御のためにパターニングされた金属を用いた新規で改良された冷陰極電子エミッタを提供することである。

【0007】本発明の他の目的は、抽出電極電流を大幅に低減した、新規で改良された冷陰極電子エミッタを提供することである。

【0008】本発明の更に他の目的は、誘電体したがって素子のブレイクダウン(breakdown)を低下させる新規で改良された冷陰極電子エミッタを提供することである。

【0009】本発明の更に他の目的は、周囲の誘電体への電子注入を減少或いは解消する新規で改良された冷陰極電子エミッタを提供することである。

【0010】本発明の更に他の目的は、動作特性および効率を改善した、新規で改良された冷陰極電子エミッタを提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】上述のおよびその他の問題の解決、および上述のおよびその他の目的の実現は、比較的平面な表面を有する基板と、この基板表面上に支持され、電子を放出する低仕事関数電子放出物質とを含む、平面冷陰極電子エミッタによって達成される。電子放出物質層上に接触導電層を配置し、それを貫通する開口を規定する。接触導電層上に絶縁層を配置し、実質的に接点導電層の開口の延長上にありかつ周辺が整合された開口を規定する。更に、絶縁層上に導電ゲート層を配置する。接触導電層は、実質的に開口の中央で放出が生じるように、電界電位(field potential)を形成する。

【0012】

【実施例】ここで図1を参照すると、電界放出素子12に組み込まれた平面冷陰極電子エミッタ10の実施例を示す、部分的側面概略図が示されている。エミッタ10は、ダイヤモンド等のような低仕事関数物質層14を有する基板13を含む。絶縁層15を層14上に付着し、それを貫通する開口17を規定する。一般的に、絶縁層15は二酸化シリコンのような酸化物で形成される。導電層18を絶縁層15上に堆積(deposit)し、電界放出素子12の抽出ゲート(extraction gate)を形成する。

光学的に透明な目視スクリーン構造体20は、陰極ルミ

4

ネセンス物質層(cathodoluminescent material layer)のような物質層22および導電陽極層23が付着された透明スクリーン21を含む。

【0013】層14(陰極)に対して十分な正電圧を陽極23に印加すると、層14から電子が放出され、陽極23と層14との間の電界によって加速され、陽極23に衝突し、結果的に層22から光子(光)が放出される。層14上に誘電体即ち絶縁層15および導電ゲート層18を配置すると、ゲート層18の電圧を変調することによって、層14の表面における電界を制御することができる。したがって、ゲート層18は電子放出を制御し、トライオード型(triode type)の素子が形成される。典型的に、陽極/陰極バイアスによる電界は、層14から電子を放出させるのに必要なバイアスよりも小さい。

【0014】トライオード素子のコンピュータ解析によって、放出プロセスは少なくとも指数関数的に熱電子的(thermionic)であり、フォーラーノルドハイム(Fowler-Nordheim)に近似することが示される。これは、表面電界への依存性において単一の指数関数よりも更に鋭い(sleep)ものである。したがって、層14の表面に沿った空間電界強度特性に小さな変化があると、空間電子放出率(spatial electron emission rates)に大きな変化が生じることになる。

【0015】開口17の直径D、絶縁層15の厚さh=Dとした図1の構造では、図2に示すように、層14の表面電界はゲート(層18)の縁で最大となり、開口17の中心で落ち込む(slump)。図2を参照すると、図1の構造における空間電界強度ε対位置Pの関係がグラフで示されており、開口17の縁で電界強度の破壊(break)が生じている。図示した具体的実施例では、開口17の中心における電界強度量の落ち込みは約3%である。電界は層18の縁で最大となり、放出電流を層18に集中させ、放出される電子の殆どを層18に集めるため、その結果ゲート電流が高くなると共に電界放出素子12の動作は非効率的となる。

【0016】図1の構造における別の問題は、層18をダイヤモンドで形成する場合、一般的に二酸化シリコン(SiO<sub>2</sub>)の絶縁層15と直接接触することである。Capacitance-Voltage Measurements on Metal-SiO<sub>2</sub>-Diamond Structures Fabricated with (100)- and (111)-Oriented Substrates", IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 38, No. 3 (1991年3月)においてGeis et al.によって指摘されたように、ダイヤモンドはSiO<sub>2</sub>内に効果的に電子を注入することができる。MOSFETやEPROMにおいて熱電子の信頼性問題によって示されたように、ある時間にわたる電荷の注入は、誘電体が結果的に破壊される(通電する)原因となる。したがって、図1の電界放出素子12には、固有の信頼性問題がある。

【0017】次に図3を参照すると、本発明による電界放出素子32内に組み込まれた平面陰極電子エミッタ30の実施例の部分的側面概略図が示されている。エミッタ30は、例えば、ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素質、非結晶性ダイヤモンド状炭素質、窒化アルミニウム物質等のような、表面仕事関数が約1.0電子ボルト未満の電界放出物質のような、低仕事関数物質層34が表面に配置された基板33を含む（本開示では、「配置(disposed)」という用語は、蒸着(vapor deposition)、エピタキシャル成長またはその他の成長、或いはその他の形成による、層の形成を意味する）。また、層34は、例えば、金属または安定物質(ballast material)およびダイヤモンド等の二重層(bilayer)のような複数の層を付着したり、金属、安定物質およびダイヤモンドの三重層(trilayer)等でも形成可能であることは理解されよう。

【0018】金属、高濃度にドーピングされた半導体物質等のような導電接触層35を層34の表面に配置する。接触層35をパターニングしてそれを貫通する開口37を規定する。絶縁層38を層35上に配置し、それを貫通する開口39を規定する。一般的に、絶縁層38は、二酸化シリコン( $\text{SiO}_2$ )のような酸化物で形成される。導電層40を絶縁層38上に配置し、電界放出素子32の抽出ゲートを形成する。導電層40をパターニングしてそれを貫通する開口41を規定する。層35を貫通する開口37、層38を貫通する開口39、および層40を貫通する開口41は、実質的に同一の広がり（coextensive）、層34、38、40を貫通する1つの連続開口を形成するように周囲が整合されている。場合によっては、開口37、39、41の縁は、パターニング、エッチング等の誤差のために、周囲が僅かにずれることがあるが、かかる誤差は「実質的」同一の範疇に属するものとする。本実施例では、開口37、39、41も断面が円形であり同心状に整合されているが、特定用途では他の形状も採用可能であることは理解されよう。

【0019】光学的に透明な目視スクリーン構造体42は、透明スクリーン43を含み、その上に陰極ルミネセンス物質層のような物質層44と導電陽極層45とが形成されている。場合によっては、層44を導電性物質で形成するか、或いは層44に導電性物質を含ませることによって、電荷を表面から遠ざけるように導く陽極として作用させる。また、場合によっては、陰極ルミネセンス物質層が良く導電しないため、付加導電性物質層を設けることもある。本実施例では、層45は透明でなければならず（例えばITO等）、透明スクリーン43の表面に付着され、更に陰極ルミネセンス物質層44が層45の表面に付着される。この構成によって、速度の低い電子が層45を通過して層44に到達する必要がなくなるので、スクリーン・バイアスを低くすることが可能と

なる（約 $<3\text{ kV}$ ）。

【0020】図3の具体的な構造では、全体的に図4に示すように、開口37、39、41の直径および絶縁層38の厚さが $h$ の場合、層34の表面電界はゲート（層40）の中央で最大となり、開口37の縁でゼロに低下する。図4は、図3の構造における、垂直方向の空間電界強度と位置 $P$ との関係を表わすグラフである。

【0021】本発明の具体的実施例では、層34をダイヤモンド状炭素で形成し、接触層35を金属で形成し、絶縁層38を二酸化シリコン( $\text{SiO}_2$ )で形成する。絶縁層38の厚さを $h=D$ とし、接触層35の厚さを $h$ の20%とした場合、図4に示すように、層34の表面に軸対称放物線状電界分布(centered parabolic field distribution)が得られる。したがって、平面陰極電子エミッタ30の放出電流は、開口37、39、41によって形成される開口の中心に集中する。この新たな電界プロファイルが形成される理由は、接触層35のために垂直方向電界分布が層34表面上の開口37の縁でゼロとなることを認識することによって、最も容易に理解されよう。

【0022】接触層35の厚さを変化させることによって、電界特性の形状が変化する。即ち、接触層35を厚くするに連れて、電界特性のピークが先鋭化し、接触層35を薄くするに連れて、平面的な電界特性になるが、軸対称の形状は変わらない。また、接触層35を厚くすると、表面層34が遮蔽されるので、電界ピーク値も減少する。絶縁層38の厚さ $h$ 、接触層35の厚さ、および開口37の直径 $D$ に対する通常の合理的な値は、 $D=h=1$ ミクロン、接触層35の厚さは0.2ミクロン、そしてゲート（層40）の厚さは0.2ミクロンである。

【0023】図5を参照すると、トライオード型電界放出素子50（図3の電界放出素子32に類似する）を模した半断面図が、コンピュータ・シミュレーションによって描かれている。このコンピュータ・シミュレーションでは、表面51が、導電層52、誘電体層53およびその上に配置されたゲート層54から成り、これらを貫通する開口55が規定されたエミッタとして機能する。シミュレーション境界(simulation boundary)56（光学的に透明な目視スクリーン構造体42を表わす）が、表面51から約4ミクロンに位置付けられる。層52、53、54の半分が、それを貫通して規定された開口55の半分と共に示されている。シミュレーション境界56の上にある数字(legend)は、開口55の中心からの距離をミクロンで示すものである。一群の線57は等電位線であり、一群の破線58は電子の経路、即ちシミュレーション境界56への軌道を示す。

【0024】図3の電界放出素子32の別の特徴が、図5のコンピュータ・シミュレーションに描かれている。このシミュレーションは、接触層(contact layer)35



7

(層52)の存在に起因する電子軌道の変更即ち合焦(focusing)を示している。接触層35がないと、電子の軌道は発散し、ゲート開口41を出て拡散する(図示せず)。接触層35の縁における垂直方向電界は接触層35によってゼロにされているので、接触層35の合焦効果は、電界遅延(field retardation)による電界線の歪み(warping)によるものである。

【0025】図3の電界放出素子32の他の特徴は、接触層35がダイヤモンド層34と絶縁層38(二酸化シリコンSiO<sub>2</sub>で形成される)との間に挟持され、ダイ

アモンドから二酸化シリコンへの電子の注入を防止することである。電子の誘電体への直接注入を防止することによって、注入によって引き起こされる信頼性の問題を解消することができる。

【0026】次に図6を参照すると、本発明による電界放出素子62に組み込まれた平面冷陰極電子エミッタ60の他の実施例の部分的側面概略図が示されている。エミッタ60は基板63を含み、この基板63の表面に金属、高濃度にドーブされた半導体物質等のような導電性物質層62が配置されている。層34について上述したものと同様の、低仕事関数物質層64を層62の表面に配置する。導電接触層65を層64の表面に配置し、それを貫通する開口を規定する。層65上に絶縁層68を配置し、それを貫通する開口を規定する。絶縁層68上に導電層70を配置し、電界放出素子62の抽出ゲートを形成し、それを貫通する開口を規定するようにパターンニングを行う。層65、層68および層70を貫通する開口は実質的に同一の広がりを持ち、層65、68、70によって完全に包囲された1つの連続開口71を形成するように、同軸状に周辺が整合されている。光学的に透明な目視スクリーン構造体72は透明スクリーン73を含み、その上に、陰極ルミネセンス物質層のような物質層74と導電層75とが形成されている。本実施例では、層75が層74(陽極接点を形成する)を被覆している。

【0027】電子エミッタ60の接触層65は、実質的に上述の図3の電子エミッタ30の層35のように動作する。導電層62を付加したために、低仕事関数物質層64との接触が強化され、導電性したがって電子放出の改善が図られる。

【0028】次に図7を参照すると、本発明による平面画像表示装置100の実施例の部分的側面概略図が示されている。実質的に光学的に透明な目視スクリーン構造体は、透明スクリーン101を含み、その上に陰極ルミネセンス物質層のような物質のエネルギー変換層111と導電陽極層110とが付着されている。この具体的実施例では、導電陽極層110上に間空(interspace)絶縁層102を配置する。間空絶縁層には、これを貫通する間空開口103が規定されており、この開口が間空領域を規定する。間空開口は全体的に円形の断面で形成され、

8

間空絶縁層102によって包囲されている。

【0029】複数の電子エミッタを電子放出基板104によって規定する。この電子放出基板104には、導電層105と、電子を放出する電子放出物質層106とが配置されている。導電接触層107を電子放出物質層106の表面上に配置し、それを貫通する開口を規定する。基板絶縁層108を接触層107上に配置し、接触層107を貫通する開口と同一の広がりを持ちかつ同軸状に整合された開口を規定する。導電ゲート層109を基板絶縁層108上に配置し、接触層107を貫通する開口と同一の広がりを持ちかつ同軸状に整合され、ゲート層109を貫通する開口を規定する。層107、108、109を貫通する個々の開口は合体して連続放出開口142を形成する。図7に示す実施例では、放出開口142が間空開口103の延長上にあり、間空開口103と実質的に一致するように、電子エミッタ140の導電ゲート層107を間空絶縁層102上に配置する。また、絶縁空間143が導電ゲート層109を部分的に分離することにより、導電ゲート層109を全体的にリング状の部分に分割し、各リング状部分が基板開口142の円周を実質的に囲むようにする。同様に、絶縁空間144によって層105、106、107を別個のリングに分離する。個々の電子エミッタを制御するために、種々のリング状部分の行または列を電氣的に接続する。

【0030】再び図7を参照すると、多数の電気ポテンシャル源162、164、166が図示されており、各々画像表示装置の1つ以上の素子に動作可能に接続されている。この説明のために例としてのみあげれば、電気ポテンシャル源162、164、166の各々は、接地電位のような基準電位に動作可能に接続することができる。しかし、これは動作の限定を意味する訳ではない。第1電気ポテンシャル源162は、導電ゲート層109と基準電位との間に動作可能に接続される。第2電気ポテンシャル源164は、導電陽極110と基準電位との間に動作可能に接続される。第3電気ポテンシャル源166は、電子放出物質層106を挟持する導電層105/107と基準電位との間に動作可能に接続される。

【0031】上述の画像表示装置の動作の間、電子放出物質層106から放出される電子は、基板開口142および間空開口103の領域を横切り、陽極ルミネセンス層111に入射し、ここで電子が光子の放出を励起する。電気ポテンシャル源162は電気ポテンシャル源166と共に、電子の放出を制御するように機能する。電気ポテンシャル源164は、引力ポテンシャル(attractive potential)を発生して、間空開口103内に必要十分な電界を形成すると共に、放出された電子を捕獲する。画素アレイの所望部分に電気ポテンシャル源162、166を選択的に印加し、電子放出物質層106の連携する部分からの電子放出を制御可能とする。このように電子放出を制御することによって、面板(faceplat

e) 101を通じて観察可能な所望の画像または複数の画像を得ることができる。

【0032】本発明による平面画像表示装置100'の別の実施例の部分的側面概略図を図8に示す。図8では、図7において既に記載した構造には同様の参照番号を付け、全ての番号にダッシュを付加して、異なる実施例であることを示す。図8に詳細に示されているように、間空絶縁層102'は、積層された複数の絶縁層150'-153'から成り、これらの内いくつかの表面には、例としてのみあげれば、モリブデン、アルミニウム、チタン、ニッケル、またはタングステンのような導電層154'-156'がそれぞれ配置されている。したがって、個々の導電層154'-156'は、隣接する絶縁層150'-153'間に挟持されている。図8は4層の絶縁層を含み、その間に3層の導電層が挟持されているが、これ以下または以上のかかる導電層および/または絶縁層を用いて間空絶縁層102'を実現することは予測できる。更に、絶縁層150'-153'のいくつかまたは全ては、導電層をその上に配置せずに形成することも予測できる。

【0033】また、図8には、導電層、ここでは代表例として導電層154'と基準電位との間に動作可能に接続された、電圧源のような電気ポテンシャル源168'も示されている。電気ポテンシャル源168'は、間空開口103'内の電界に所望の変更を加え、エネルギー変換層111'に移動中の放出電子の軌道に影響を与えるように選択される。望まなければ、図示していない他の電気ポテンシャル源を、他の導電層155', 156'において同様に用いることもできる。

【0034】次に図9を参照すると、本発明による電界放出素子32'に組み込まれる平面冷陰極電子エミッタ30'の更に他の実施例の部分的側面概略図が示されている。図9の構造は図3の構造に類似しており、同様の構成要素は同様の番号で表し、全ての番号にダッシュを付けることによって異なる実施例であることを示す。エミッタ30'は基板33'を含み、その表面上に低仕事関数物質層34'が配置されている。先に説明したように、層34'は、基板上に金属および/または安定物質およびダイヤモンド等の複数の層を配することによって、形成することができる。

【0035】導電接触層35'を層34'の表面上に配置する。接触層35'をバタニングして、それを貫通する開口37'を規定する。絶縁層38'を層35'上に配置し、それを貫通する開口39'を規定する。導電層40'を絶縁層38'上に配置し、電界放出素子32'の抽出ゲートを形成する。導電層40'をバタニングして、それを貫通する開口41'を規定する。層35'を貫通する開口37'、層38'を貫通する開口39'、および層40'を貫通する開口41'は実質的に同一の広がりを持ち、周囲を整合して1つの連続開口を

形成する。

【0036】図9には開口37', 39', 41'の一方の縁しか示されていないが、他方の縁も「遠くに(far away)」存在するので、互いの電界分布を変えることはない。開口37', 39', 41'は大きな円形断面を有してもよいが、これらを細長チャンネル等としてもよい。事実上分離している開口37', 39', 41'の縁によって、比較的大きな形成(例えば、リソグラフィ/バタニングによる)を可能とすると共に、構造の製造を比較的容易にする。

【0037】光学的に透明な目視スクリーン構造体42'は透明スクリーン43'を含み、その上に、陰極ルミネセンス物質層のような物質層44'と透明導電陽極層45'とが形成されている。本実施例では、層45'を透明スクリーン43'の表面上に配し、陰極ルミネセンス物質層44'を層45'の表面上に配することにより、スクリーン・バイアスの低下が可能となる。

【0038】図9の構造に対する電界分布のシミュレーションを図10のグラフに示す。ここでは、垂直方向空間電界強度 $\epsilon$ と図9の構造における位置Pとの関係をプロットした。層34'の表面上における電界分布によって、層40'(ゲート)の縁から遠いところで電子放出が生じる。軌道シミュレーションが示すのは、軌道は分散する、即ち合焦しないが、放出電子はゲートには達しない(miss)ということである。これに類似する実施例において放出電子を合焦するには、例えば、図8に示した構造に似た構造では、1層以上の導電層154'-156'を利用すればよい。

【0039】以上、電子放出制御にバタニングされた金属を用いる、新たな改良された冷陰極電子エミッタが開示された。この新たな改良された冷陰極電子エミッタの新規な構造のために、周囲の誘電体への電子注入は減少または解消され、抽出電極電流は大幅に低減される。また、周囲の誘電体への電子注入を減少することによって、誘電体即ち素子のブレイクダウンを大幅に低下させ、素子の信頼性を格段に向上させることになる。また、前記新たな改良された冷陰極電子エミッタの新規な構造は、動作特性および効率も向上させるものである。先の利点に加えて、前記新たな改良された冷陰極電子エミッタは、遠隔に配置された陽極において電子ビームを自動的に合焦する機能を組み込むことにより、表示装置等におけるエミッタの使用を改善することができる。結果的に、電子放出層と陰極ルミネセンス層との間に別個の支持用スペーサを用いない、構造的に堅牢(sound)な画像表示装置が開示された。

【図面の簡単な説明】

【図1】平面電界放出表示装置の実施例を表わす部分的側面概略図。

【図2】図1の構造における空間電界強度対位置の関係を示すグラフ。

12

18, 40, 40', 52 導電層

20, 42, 42' 目視スクリーン構造体

22, 44, 44' 陰極ルミネセンス物質層

23, 45, 45', 110 導重陽極層

35, 35', 65, 107 導電接觸面

40, 70, 105, 154' - 156' 導電層

43, 43', 73, 101 透明スクリーン

50 トライオード型電界放出素子

### 5.3 誘電体層

10 54 ゲート層

## 7.1 連續開口

101 面板

102, 102' 間空絶縁層

103 間空開口

## 104 電子放出基板

106 電子放出物質層

108 基板絶縁層

109 導電ゲート層

111 エネルギー変換層

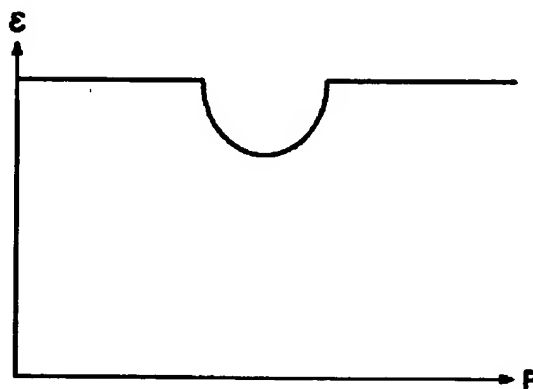
20 140 電子エミッタ

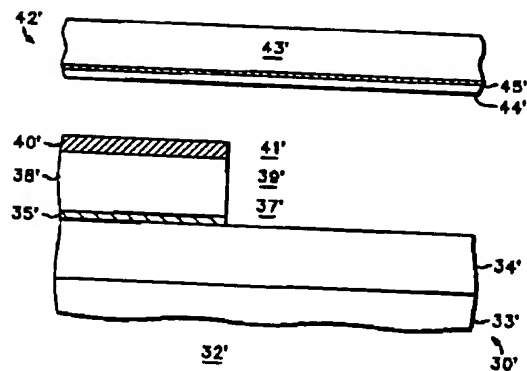
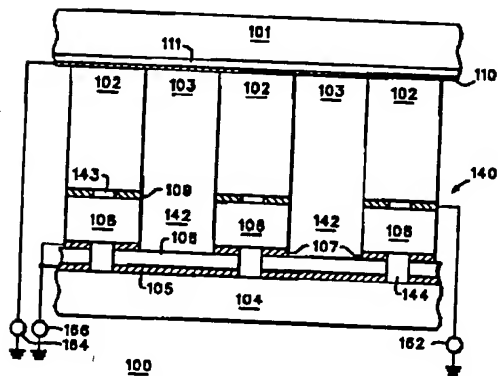
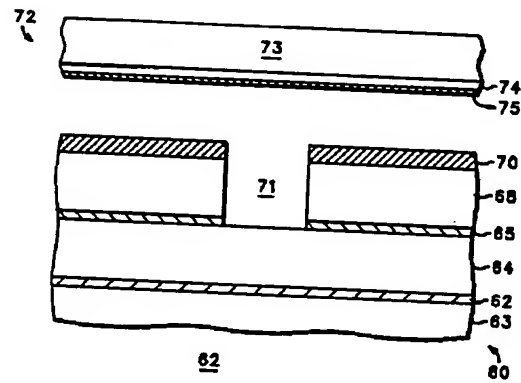
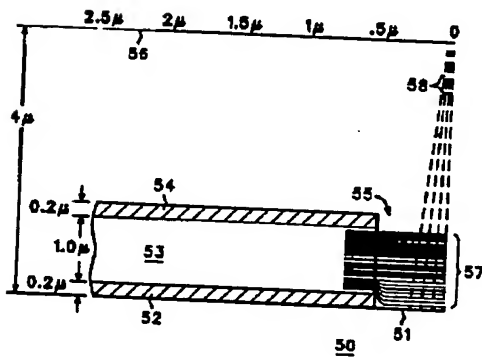
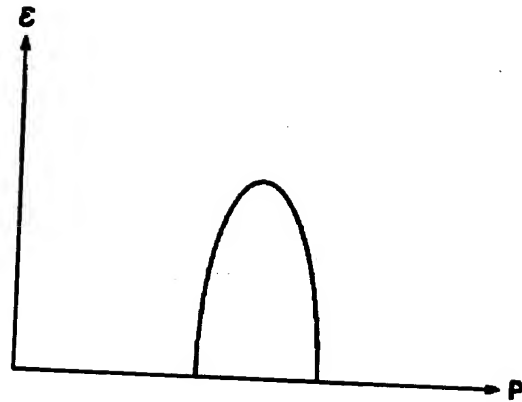
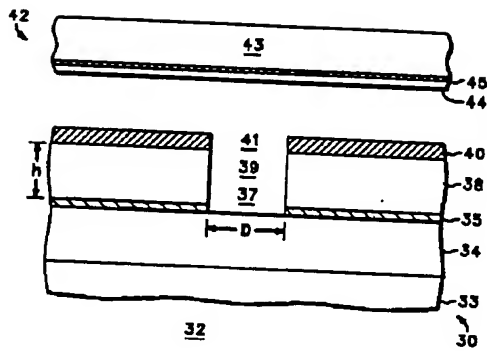
## 142 連續放出開口

### 1 4 3 絶縁空間

162, 164, 166, 168' 電気ポテンシャル  
源

【图 2】

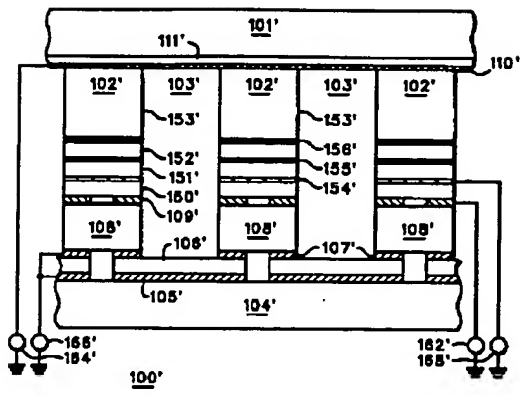




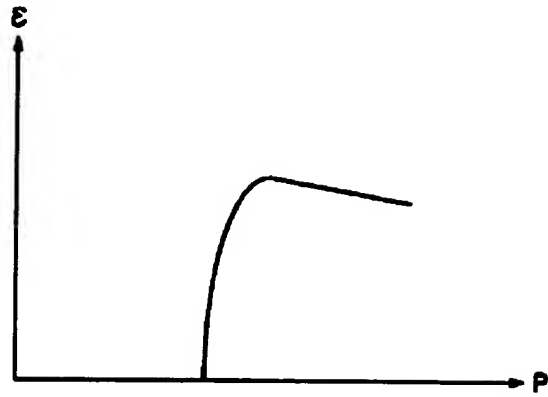
(9)

特開平8-55564

【図8】



【図10】



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**